

CEOインタビュー

さらなる飛躍への挑戦

ワールドクラスのROE・営業利益率の実現に向けて

Question

01

2期連続で過去最高益を更新しましたが、中期経営計画の進捗をお聞かせください。

過去最高益を2期連続で更新できたことは、中期経営計画における取り組みの成果の一つとして私自身非常に喜ばしく思っています。

当社は、技術革新と市場成長が見込まれ、かつ当社の強みが生かせる分野での成長を目指しています。この方針に基づいてコータ/デベロッパでは

すでに圧倒的な地位を築いていますが、2015年に新たにエッチング・成膜・洗浄の3つを成長注力分野と位置付け、製品の競争力・顧客対応力・生産性のいっそうの向上を通して“Best in Class”の企業となるべく、鋭意取り組んでまいりました。

過去3年間を振り返ると、半導体前工程製造



Tony Kawada

代表取締役社長・CEO
河合 利樹

CEOインタビュー

装置(WFE)*市場は300億ドル規模から500億ドル規模へと、これまでにない成長を遂げています。そのような状況のもと、当社は開発・生産グループやビジネスユニットの再編、プロセスインテグレーションセンターの設立、各製品の強みやBKM (Best known method) の融合を通して、機動的かつ効率的に開発を行える体制を築いてきました。また、お客さまとの開発協業を推進し、付加価値の高い製品を従来以上に迅速に提供できるよう尽力してきました。

これらの結果、各注力分野における売上高、利益率、市場シェアが大きく向上しました。さらに、業界随一の納入済み装置台数とサポート力を強みに、


フィールドソリューション事業(パーツ・中古機販売、改造・保守サービス)も売上高の22%を占めるまでに成長しました。今後も、拡大する市場と業界をリードする当社の技術力、製品競争力を背景に、一段上の成長を成し遂げます。

*半導体前工程製造装置(WFE; Wafer fab equipment) : 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

営業利益率26.5%を確保できるコスト下方柔軟性の高い経営体質を構築していきます。

財務モデルは一新しましたが、“Best in Class”を実現するという中期経営計画の基本戦略に変更はありません。拡大する事業機会を最大限成長に結びつけるため、設備投資額・研究開発費の目安を引き上げ、開発・生産能力を高めていきます。エッチング装置事業においては、工場での自動倉庫システムの導入と生産ラインの増設を行うとともに、新開発棟の稼働によって次世代技術の開発を

加速します。成膜装置事業においても、新たな生産棟を建設し、将来の需要増に備えた生産設備の増強を行っていきます。また同時に、固定費や対売上高販管費比率のコントロールをしっかりと行うことで、新財務モデル、そして中長期のROE・営業利益率目標の達成につなげてまいります。

 中期経営計画の詳細は、こちらをご覧ください
www.tel.co.jp/ir/policy/mplan/

■ 新財務モデル(2021年3月期)

WFE市場規模	550億ドル	620億ドル
売上高	1兆5,000億円	1兆7,000億円
営業利益率	26.5%	28%
ROE(自己資本利益率)	30~35%	

Question

02

2018年5月に新財務モデルを発表されましたが、その背景を教えてください。

IoT・AI(人工知能)時代の到来により半導体・FPD産業は新たな成長局面を迎えており、今後WFE市場は600億ドルを超える規模になると期待しています。当社はこれを成長の好機と捉え、中長期的にワールドクラスのROEと30%以上の営業利益率を目指しています。

この道筋として示したものが、今回発表した

2021年3月期の新財務モデルです。従来の財務モデルと比較して、新たなモデルではWFE市場規模の想定を620億ドルへと引き上げ、売上高1兆7,000億円・営業利益率28%の達成を目標として掲げています。一方で、半導体の需給動向などの一時的な市況変化によって仮にWFE市場規模が550億ドルに縮小しても、売上高1兆5,000億円・

CEOインタビュー

Question

03

半導体・FPD産業が新たな成長局面を迎えているという点について、もう少し詳しくお聞かせください。


今、社会はIoT・ビッグデータを軸とする第四次産業革命に突入しています。ネットワークでつながるモノから生まれる膨大なデータを分析・活用する仕組みが生まれ、産業構造や社会全体を変えるような新しいサービスが次々に登場すると予想されています。

この核となるのがデータの処理と分析、すなわちクラウドコンピューティングとAIです。さらには自動運転やスマートファブなど、通信遅延の許されないサービスの実現には、クラウドよりもっと、ユーザーに近い場所で処理を行うエッジコンピューティングが求められています。これらの発展

には、半導体の技術革新が必要不可欠です。FPDにおいても、従来のテレビやモバイルに加えてAR/VR、フレキシブルディスプレイなどの新用途が生まれるとともに、高精細・低消費電力化がますます重要となります。

このような半導体・FPDの技術要求の高まりと用途の広がりを背景に、お客さまのニーズが「点」から「線」へと変化しつつあります。次の技術世代だけでなく数世代先で生じる課題も見据えての

製品開発に加え、単一装置の性能向上だけでなく製造プロセス全体の最適化を実現するソリューション提供が求められています。また、研究開発から量産開始までのスピード向上、AIやビッグデータを活用した新しいサービスなど、あらゆる面でのイノベーションが製造装置メーカーに期待され始めています。

 半導体の進化を支える技術革新については、9および10ページをご覧ください

Question

04

顧客のニーズが変化の中で、TELの強みがどのように生きるのでしょうか？

当社の強みは、ハードウェア、ソフトウェア、プロセス技術、サービスの4つを兼ね備えていることです。この強みを生かし、お客さまの製造プロセス全体、ひいては製造ラインのオペレーションの向上に貢献していきます。

第一に、当社の持つ幅広い製品ラインアップとプロセス技術を生かして、製造プロセス全体を俯瞰したソリューションをいち早くお客さまに提供すべく、初期段階からの共同開発を推進しています。昨年のプロセスインテグレーションセンター設立はこの活動の一環であり、早くもその

取り組みが評価されつつあります。

第二に、お客さまの工場におけるサポート強化と、当社開発部門・ビジネスユニットとのシームレスな連携により、お客さまの半導体デバイスの開発から量産までの期間短縮に寄与していきます。

第三に、業界でも最大規模の66,000台の納入済み装置から得られる知見やデータをもとに、今後は装置のアップタイムや製造歩留まりを向上させるような、お客さまにとって価値の高い新しいサービスの提供も進めていきます。



CEOインタビュー

多方面に拡大するお客さまのニーズに対し、その期待に応えられる製造装置メーカーは世界でも限られています。当社はその数少ないメーカーの

一つであり、革新的な技術力とサポート力を強みに、今後当社の活躍機会はますます広がるものと確信しています。

Question

05


サステナビリティへの取り組みについて教えてください。

企業の成長は人、すなわち社員こそが持続的な価値創造の源泉です。私はCEO就任以来、社員とその家族を豊かにできる会社を作ることを目指してきました。一人ひとりが高いモチベーションを持って業務に取り組めるよう、また優秀な人材を確保できるように、新グローバル人事制度を導入し、職責の明確化と評価の公平性を高めています。また、中期業績に連動したインセンティブプランを導入し、社員と経営陣とが一体となって企業価値向上に努める仕組みを整えました。さらに、工場や現地法人に赴いて社員との対話の場を設け、積極的に現場とのエンゲージメントを深めています。社員のベストパフォーマンスを引き出す取り組みが持続的な成長につながると信じています。

加えて、企業が果たすべき社会的責任が増す中、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)などの潮流に照らしたESGへの取り組みもいっ

そう推進していきたいと考えています。実効性の高いガバナンスを追求し、新たな社外取締役の招聘や長期戦略に関する多角的な討議を行っています。環境面では、当社製品の環境負荷の低減のみならず、当社製品を用いて製造される半導体デバイスの消費電力抑制に寄与する取り組みも進めています。

このような施策を通じ、社会的責任を果たす持続可能性の高い企業を目指して邁進してまいります。

 当社のESGに関する取り組みの詳細は、11から14ページ、および「サステナビリティレポート2018」をご覧ください



Question

06

手元資金の使途について、どのようにお考えでしょうか。

手元資金の使途として最も優先するのは、革新的な技術のさらなる創出に向けた成長投資です。当社が持つ技術や強みを生かすことができ、かつ将来の市場成長が期待できる分野に注力したいと考えています。また、成長の可能性を最大限引き出すため、有望な要素技術の研究開発にも力を入れていきます。

株主還元については、業績連動型の配当制度を基本とし、配当性向を50%と定めています。

当期の1株当たり年間配当額は、4期連続で過去最高となる624円といたしました。自己株式取得については、成長投資や手元資金、マクロ経済の動向などを総合的に勘案し、機動的に実施を検討していきます。今後も利益成長を通じて、持続的な企業価値の向上と株主価値の最大化に努めてまいります。